

檢測報告 Test Report



報告編號 A223005486310100501E
Report No. A223005486310100501E

第 1 頁 共 8 頁
Page 1 of 8

報告抬頭公司名稱 瑞昇金屬工業股份有限公司/南通鈞元電子材料工業有限公司
Company Name REDSUN METAL IND. CO., LTD./NANTONG CHUN-YUAN EDELECTRONICS IND. CO., LTD.
地 址 320030 桃園市中壢區定寧路2號/江蘇省南通市如東縣洋口化學工業園區黃海三路振洋二路交叉口
Address NO.2, DINGNING RD., ZHONGLI DIST., TAOYUAN CITY 320030 /NANTONG JU-TUNG HSIEN, YANG KOU CHEMICAL INDUSTRIAL AREA, RUDONG, JIANGSU

以下測試之樣品及樣品資訊由申請者提供並確認

The following sample(s) and sample information was/were submitted and identified by/on the behalf of the applicant

樣品名稱 LEAD FREE SOLDER (無鉛錒錫製品)
Sample Name LEAD FREE SOLDER (無鉛錒錫製品)
樣品接收日期 2023.02.16
Sample Received Date Feb. 16, 2023
樣品檢測日期 2023.02.16-2023.02.22
Testing Period Feb. 16, 2023 to Feb. 22, 2023

檢測要求 根據客戶要求, 對所提交樣品中的鉛(Pb), 鎘(Cd), 汞(Hg), 六價鉻(Cr(VI)), 多溴聯苯(PBBs), 多溴二苯醚(PBDEs), 鄰苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)進行測試。
Test Requested As specified by client, to test Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls (PBBs), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs), Phthalates (DBP, BBP, DEHP, DIBP) in the submitted sample(s).

檢測依據/檢測結果 請參見下頁。
Test Method/Test Result(s) Please refer to the following page(s).



馮智聰

實驗室經理 Laboratory Manager

日 期
Date

2023.03.17

No. R556661980

台灣華測檢測技術有限公司檢測中心
Testing Center Centre Testing International (Taiwan) Co., Ltd.

桃園市蘆竹區南坎路二段9號5樓之6
5F-6, No.9, Sec.2, Nankan Rd, Luzhu Dist., Taoyuan, Taiwan